

Title (en)

Micro-switch and method of manufacturing the same

Title (de)

Mikroschalter und Verfahren zu dessen Herstellung

Title (fr)

Microcommutateur et son procédé de fabrication

Publication

**EP 1191559 A2 20020327 (DE)**

Application

**EP 01120498 A 20010828**

Priority

DE 10043549 A 20000901

Abstract (en)

Microswitch has two conducting contact elements (6) that can be connected to external circuit elements and moved relative to each other by application of a magnetic field. At least one of the contacts is in the form of a thin plate (7) lying parallel to the support medium (1) and free to move with respect to it. The other contact is parallel to the support and contact is made between the two plates along their edges. Application of a magnetic field of sufficient strength causes a contact to be made. An Independent claim is made for a production method for the above microswitch using semiconductor integrated circuit manufacturing techniques.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Mikroschalter mit mindestens zwei elektrisch leitfähigen, mit externen Schaltungseinheiten verbindbaren Kontaktelementen (6), deren relative Position zueinander durch eine eingeprägte Magnetkraft veränderbar ist, wobei mindestens ein magnetisierbares Kontaktelement beweglich gelagert ist, so daß mindestens zwei Schaltzustände einstellbar sind, und wobei zumindest das magnetisierbare Kontaktelement als dünne Platte (7) ausgebildet ist, die im wesentlichen parallel zu einem Trägersubstrat (1) beweglich ist, und daß beide Kontaktelemente in einer Ebene parallel zum Trägersubstrat angeordnet sind, wobei jeweils eine Seitenfläche der Kontaktelemente als Schaltfläche dient. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Mikroschalters. <IMAGE>

IPC 1-7

**H01H 1/00; H01H 36/00**

IPC 8 full level

**H01H 1/00** (2006.01); **H01H 1/66** (2006.01); **H01H 36/00** (2006.01); **H01H 50/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01H 1/0036** (2013.01); **H01H 1/66** (2013.01); **H01H 36/00** (2013.01); **H01H 50/005** (2013.01); **H01H 2001/0078** (2013.01); **H01H 2036/0093** (2013.01)

Cited by

DE102007028292B4; EP1441375A4; EP1856708A4; US2010176899A1; US8624466B2; US8258900B2; US9284183B2; WO2008155296A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1191559 A2 20020327; EP 1191559 A3 20050302**; DE 10043549 C1 20020620

DOCDB simple family (application)

**EP 01120498 A 20010828**; DE 10043549 A 20000901